

## 從創新走向量產

### Manz 亞智科技 CoPoS 技術藍圖成形 台灣半導體創新研發中心啟用

【台灣桃園 – 2025 年 4 月 14 日】全球領先的半導體面板級封裝設備製造商 **Manz 亞智科技**，持續以先進設備整合與製程創新驅動產業技術升級，積極推動 **CoWoS** 面板化即 **CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate)** 技術成形，加速技術落地與多元應用場域的開展。為強化技術研發實力，Manz 亞智科技於桃園設立「半導體創新研發中心」，建構具備試驗與量產能力的 **CoPoS RDL 重佈線層設備**，以其橫跨多元產業的製程整合優勢，帶動台灣在半導體面板級封裝設備供應鏈中的關鍵地位。

### 強化半導體事業布局，啟動獨立運營，打造垂直整合服務鏈



Manz 亞智科技總經理林峻生(左)與 Manz AG 重整管理團隊 Martin Mucha 代理人(右)簽訂收購協議

面對先進封裝市場的高速成長，Manz 亞智科技於 2025 年第二季完成對德國 Manz AG 的收購，正式邁入獨立運營新階段，全面啟動半導體設備事業的深耕與擴展，並積極建立具全球競爭力的營運體系。

公司營運重心聚焦於 **CoPoS** 技術與金屬化製程設備的研發、設計、生產、裝機調試與客戶服務，打造垂直整合的一站式解決方案。透過與客戶的緊密協作，Manz 亞智科技持續強化製程整合與系統導入能力，提升整體產線效率與品質穩定性，協助客戶因應高速演進的技術挑戰，實現從研發到量產的無縫接軌，加速先進封裝技術的落地與商業化應用。

### 精密製造實力，半導體面板級封裝設備的隱形推手

Manz 亞智科技根植於精密化學濕製程、電鍍與自動化設備領域，累積近四十年專業技術與應用經驗，並成功拓展至 PCB、IC 載板與顯示器產業。憑藉深厚的技術底蘊與創新實力，Manz 亞智科技率先布局半導體面板級封裝及 **CoPoS** 技術，成為背後關鍵的

設備推手。透過推動 CoPoS 技術，Manz 亞智科技帶動供應鏈間的協同發展，開啟跨界整合與多元應用的新篇章。

## RDL 製程優化，提升封裝效能

RDL (重佈線層) 對導電性能、穩定性及良率具有關鍵影響。Manz 亞智科技針對不同封裝結構、基板及基板厚度提供關鍵蝕刻與電鍍設備：

- **電鍍設備**：支援有機基板盲孔與玻璃基板通孔 TGV 製程，確保高均勻性，兼容保型銅電鍍與填孔電鍍。
- **蝕刻設備**：具備高縱深比 ( $AR > 1:20$ )，支援厚度 0.2mm ~ 1.1mm 基板，確保高密度封裝信號的完整性與導電需求。

## 以台灣為核心，布局全球市場，並行技術創新與高效製造

因應全球供應鏈區域化趨勢，Manz 亞智科技整合全球資源與區域化策略，重點布局：

- **台灣半導體創新研發中心**：台灣作為全球半導體技術樞紐，Manz 亞智科技於此建立研發總部，推動 PLP (面板級封裝) 與 TGV (玻璃基板) 之 RDL 金屬化設備技術發展，並與客戶密切合作，提供打樣與製程驗證，快速回應市場需求。
- **區域化發展**：面對半導體市場區域化趨勢，Manz 亞智科技除了在台灣深耕外，積極布局美國、日本及東南亞據點，協助客戶彈性調整區域供應鏈變革。
- **綠色製造與智慧生產**：作為台灣唯一成功開發數位噴印成膜設備供應商，Manz 亞智科技實現無光罩製程，適用於晶圓級與面板級封裝後段金屬化製程，簡化生產流程，提升效率，並降低能耗與材料損耗，推動半導體製造向綠色永續發展。



Manz 亞智科技於台灣設立半導體創新研發中心，從設備開發到製程驗證，全方位支援客戶打樣與技術導入。

## 持續推動半導體面板級封裝技術發展

Manz 亞智科技總經理林峻生表示：「台灣作為全球半導體製造的重要樞紐，封裝產業的發展不僅日益關鍵，更趨向跨產業整合。同時，區域供應鏈重塑加速，各國積極強化本土供應鏈，以確保技術與生產穩定性。在這樣的趨勢下，Manz 亞智科技將持續深化核心技術，攜手區域夥伴，共同提升供應鏈韌性，確保客戶的生產靈活性與競爭力。」

他進一步指出：「我們在台灣設立研發中心，持續創新並提升 CoPoS 面板級封裝設備的技術及設備優勢，確保在先進封裝領域保持領先地位。其次，針對全球市場對在地供應鏈的需求，我們將強化區域布局，提升供應鏈韌性，確保設備快速滿足不同區域客戶的技術與產能需求，並建立緊密的夥伴關係。最後，我們不僅專注於技術突破，也積極推動綠色製造與智慧生產，透過新設備技術降低能耗與材料損耗，協助客戶實現更具永續性的生產模式。」

展望未來，Manz 亞智科技將持續引領半導體封裝設備技術的發展，攜手客戶與產業夥伴，共同推動台灣成為全球半導體封裝技術創新的關鍵基地，為產業帶來更高效、更具競爭力且更永續的解決方案。

### 關於 Manz 亞智科技

Manz 亞智科技是領先的半導體面板級封裝設備製造商，以 CoPoS ( CoWoS 面板化 ) 技術框架下為核心，推動面板級封裝技術與製程創新。從實驗室與試生產的小量訂製設備，到標準化模組設備及量產線，提供完整的設備解決方案，涵蓋化學濕製程、電鍍、高精度噴墨印刷、自動化設備及自主開發的軟體整合技術，滿足各階段重佈線層 RDL 製程需求，廣泛應用於扇出型面板級封裝 ( FOPLP )、玻璃通孔 ( TGV ) 及 IC 載板生產。

聚焦半導體面板化製程，Manz 亞智科技致力於提升生產品質、效率與產能，推動晶片製造邁向更高效、更靈活。



了解半導體 CoPoS 封裝技術解決方案，請掃描下載。

媒體聯絡人：

黃筑青 Yvonne Huang

Manz 亞智科技 | 行銷公關處長

電話：03-452-9811 ext: 3399

電子郵件：[yvonne.huang@manz.com](mailto:yvonne.huang@manz.com)